

杭州立昂微电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年3月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2740号),由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、联合主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式,向22名特定对象发行了人民币普通股(A股)56,749,972股,发行价格人民币91.63元/股,募集资金合计519,999.99万元。根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联合主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的承销与保荐协议,公司应支付承销费用、保荐费用含税合计4,287.70万元(其中不含税金额为4,045.00万元,增值税进项税额为242.70万元),其中应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用3,232.80万元(含税),中信证券股份有限公司承销费用275.19万元(含税)和中国国际金融股份有限公司承销费用779.71万元(含税);公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐有限公司的承销费用、保荐费用3,232.80万元(含税)后的余额516,767.20万元已于2021年10月8日分别存入公司开立的各募集资金专户,其中在宁波银行股份有限公司杭州城东支行71060122000538713银行账号存入228,800.00万元;兴业银行股份有限公司宁波北仑支行388010100101681858银行账号存入78,422.00万元;中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行39310001040013388银行账户存入62,778.00万元;上海浦东发展银行宁波鄞州支行94170078801600002029银行账户存入146,767.20万元。另减除律师费、审计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用736.67万元后,公司本次募集资金净额为515,218.33万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2021年10月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7259号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000538713	2,288,000,000.00	788,497.10	
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000538866	-	850,313,780.70	
宁波银行股份有限公司杭州分行	71010099000243926000001	-	31,259,455.69	
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010100101681858	784,220,000.00	132,255,120.28	
	388010100204427849		200,000,000.00	[注 1]
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040013388	627,780,000.00	1,900,947.86	
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200133058	-	176,694,577.51	
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260641000004794	-	7,380,000.00	
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	94170078801600002029	1,467,671,972.85	1,512,740.37	
合 计		5,167,671,972.85	1,402,105,119.51	

[注 1] 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行账号 388010100204427849 系募集资金专户 388010100101681858 关联的定期存款账户，该募集资金专户实际余额为 332,255,120.28 元。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 515,218.33 万元。按照募集资金用途，计划用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号	环评文号
年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目	346,005.00	228,800.00	2018-330800-39-03-071327-000	衢环集建【2020】32 号
年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	80,259.00	78,422.00	2102-330155-89-02-308142	杭环钱环评批【2021】15 号

年产 240 万片 6 英寸硅 外延片技术改造项目	66,101.00	62,778.00	2103-330851-04- 02-407856	循环智造建 【2021】9 号
补充流动资金	150,000.00	149,999.99		
合 计	642,365.00	519,999.99		

截止 2022 年 3 月 31 日，实际已投入资金 362,718.11 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848 号）。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用闲置资金暂时补充流动资金共 14,000.00 万元，闲置资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 1,402,105,119.51 元，其中前次募集资金结余为 1,385,002,090.60 元，利息收入扣除银行手续费的净额为 15,814,661.00 元，尚未支付的发行费用印花税为 1,288,367.91 元，不存在节余使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			519,999.99			已累计投入募集资金总额			362,718.11		
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额			362,718.11		
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2021 年			318,813.62		
						2022 年			43,904.49		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目	228,800.00	228,800.00	141,411.70	228,800.00	228,800.00	141,411.70	-87,388.30	截止 2022 年 3 月 31 日该项目累计工程投入占预算的 72.07%，项目已转固原值 188,019.34 万元	
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	78,422.00	78,422.00	31,576.37	78,422.00	78,422.00	31,576.37	-46,845.63	该项目尚未达到预定可使用状态	
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	62,778.00	62,778.00	44,382.88	62,778.00	62,778.00	44,382.88	-18,395.12	该项目尚未达到预定可使用状态	
4	补充流动资金	补充流动资金	149,999.99	149,999.99	145,347.16	149,999.99	149,999.99	145,347.16	-4,652.83	不适用	
合计			519,999.99	519,999.99	362,718.11	519,999.99	519,999.99	362,718.11	-157,281.88		

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日

编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目	6.86%	未做分期承诺	不适用	-3,741.53	-271.92	-4,013.45	否[注 1]
2	年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目	不适用	未做分期承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目	不适用	未做分期承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 年产 180 万片集成电路 12 英寸硅片项目 2021 年度实现营业收入 16,493.87 万元，实现毛利-2,873.57 万元，实现净利润-3,741.53 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 9,458.17 万元，实现毛利 596.56 万元，实现净利润-271.92 万元，截止 2022 年 3 月 31 日，累计实现效益-4,013.45 万元。该项目建设期为 48 个月，从第 3 年开始达到生产负荷的 40%，第 4 年达到生产负荷的 80%，第 5 年及以后达到生产负荷的 100%。该项目 2021 年度和 2022 年度分别处于项目建设的第 3 年和第 4 年，仍处于项目建设期及产能爬坡期，故未达到生产负荷 100%时的预计效益。

[注 2] 年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目尚未达到预定可使用状态。